



信竑科技股份有限公司
TRUSVAL TECHNOLOGY CO., LTD.

股票代碼：6667

高科技廠務專家與系統包整合領導商
信竑科技股份有限公司



本簡報及同時發布之相關訊息內容來自公司內部及外部來源所取得之預測結果。本公司未來實際所發生之營運結果、財務狀況及業務展望，可能因為各種無法掌握之風險因素，導致與預測性資訊所明示、暗示預估有所差異。



本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前對於未來的看法。對於這些看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

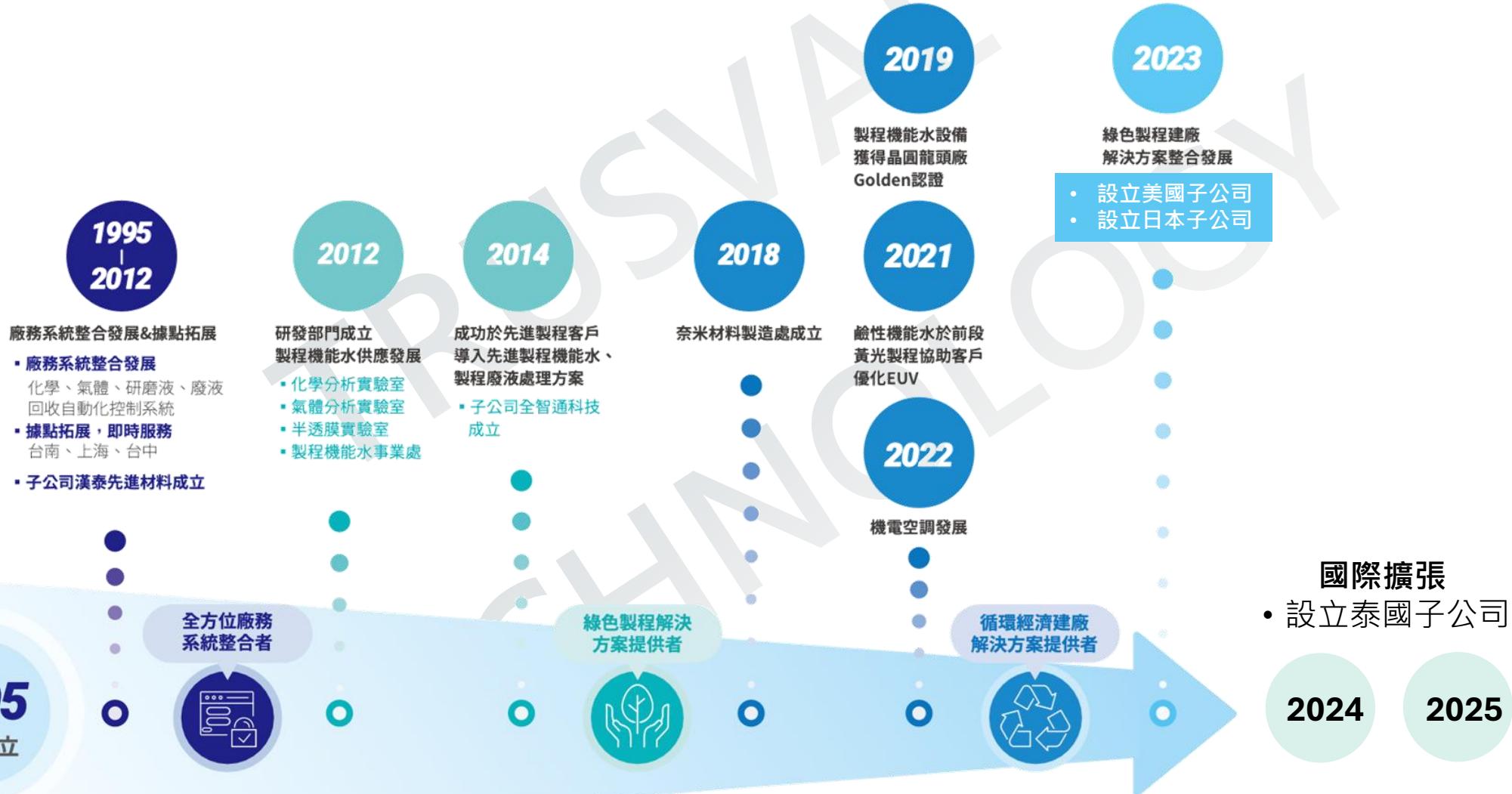


本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊正確性、公正性或完整性。

目錄



- 公司簡介
- 營運概況
- 競爭優勢
- 市場分析
- 未來發展
- 企業社會責任



高科技廠務系統與國際統 包服務的整合領導者

信紘科總部設立於台灣苗栗縣，並於台灣高
科技產業主要據點台中及台南皆設有辦事處，以
提供客戶最即時的服務。

跟隨先進製程客戶海外佈局需求也於海外設立
子公司，現共有美國亞利桑那州、日本東京與
泰國曼谷共三處，主要提供工程規劃、系統整
合、設備製造與現場工程等服務內容。

執行長	成立時間
王怡文 龔楚喬 林欣德	1995
資本額	員工人數
492,789 千元	信紘科技 596 子公司 219



公司簡介

營運概況

競爭優勢

市場分析

未來發展

企業社會責任



高科技製造業

特氣特化廠務供應設備
二次配工程
製程廢液處理解方
製程化學品減量設備：機能水

循環經濟

廠區與系統建置統包
廢棄物回收資源化解決方案系統
零廢減碳服務與系統設計代操
再生產品製造與銷售



一般產業

電子業廠辦、商業住宅、國防、醫院、數據中心

營造與機電統包工程
五大管線/ HVAC冷凍空調
高低壓配電盤/控制盤

CDA/N2/真空/廢氣/消防
弱電系統/給排水/廠辦裝修
無塵室建造工程

高科技建廠全生命週期能力 × 海外市場同步擴張

國內市場

高科技建廠 全生命週期 廠務服務

- **廠務供應系統整合**
廠務供應系統設計/施工、純廢水、氣體化學品系統、模組預組、設備安裝、監造管理。
- **二次配工程**
設備拆裝機、配管施工、現場管理。
- **擴建與改善工程**
產線擴增之廠務拆裝設備工程
- **成廠維護與長駐服務**
駐點維運、人力派駐、年度歲修與緊急維修。
- **設備/零配件/耗材銷售**

綠色建廠 綠電、低碳能源

- 綠色製造與製程設備
- 化學品減量設備
- 技術評估與方案提供
- 循環經濟系統整合

營建設施

機電統包

從中型機電統包案切入，衍伸廠務特氣特化領域外營建無塵室機電、五大管線等各項工程

海外市場

以台灣成熟的工程能力為核心，結合在地法規與人力模式，協助客戶快速、安全地完成新建或擴建廠建設。

美

日

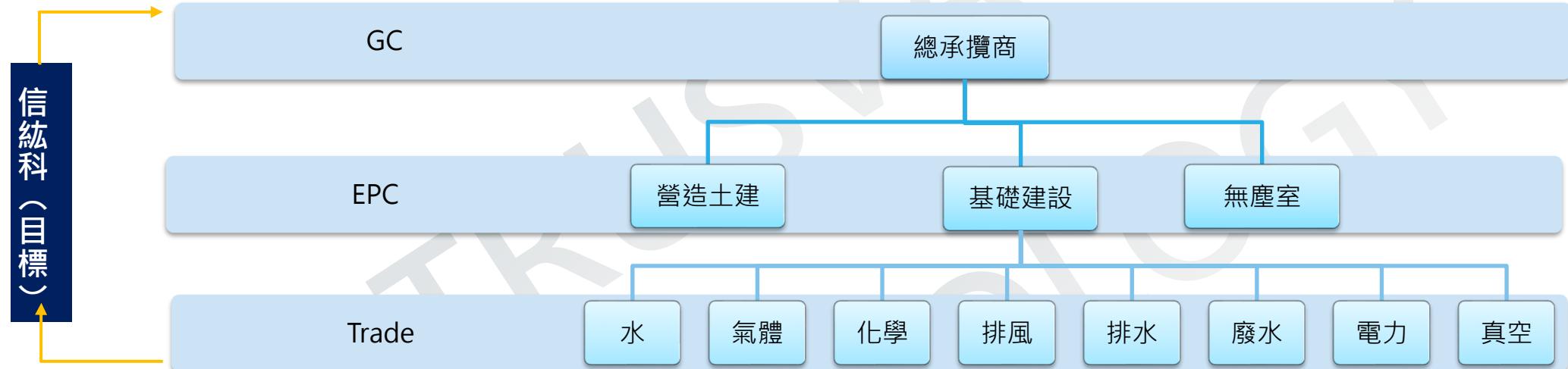
泰

新加坡

德



信穎科技股份有限公司
TRUSVAL TECHNOLOGY CO., LTD.



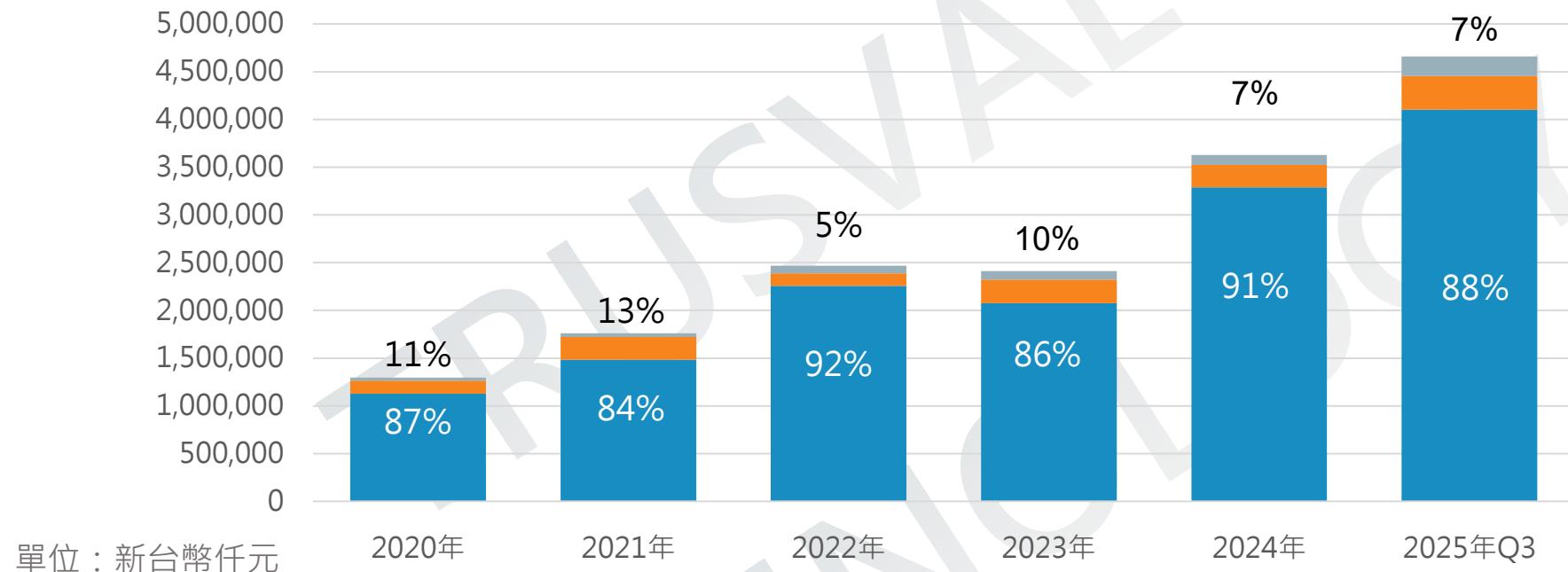
GC (General Contractor) 總承包：主要為與業主協調，透過管理現場、排程、進度與安全下，確保成本、品質及時程能滿足。

EPC(Engineering, Procurement, Construction) 統包商：設計、採購、建造一條龍統包。

Trade專業分包商：具備高複雜度技術之特定項目領域專家。

(台灣因豐富高科技廠建廠案，造就完整產業鏈，形成特有高彈性、高效率、成本具有競爭力之優勢)

■ 高科技產業製程之廠務供應系統整合 ■ 綠色製程解決方案 ■ 其他



項目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年Q3
高科技產業製程之廠務供應系統整合	1,125,878	1,484,940	2,258,093	2,076,093	3,287,663	4,104,369
綠色製程解決方案	139,162	235,785	129,417	247,724	237,520	348,851
其他	30,795	40,378	79,695	88,813	102,598	207,089
合計	1,295,835	1,761,103	2,467,205	2,412,630	3,627,781	4,660,309

營運概況-近五年損益表

股票代碼：
6667

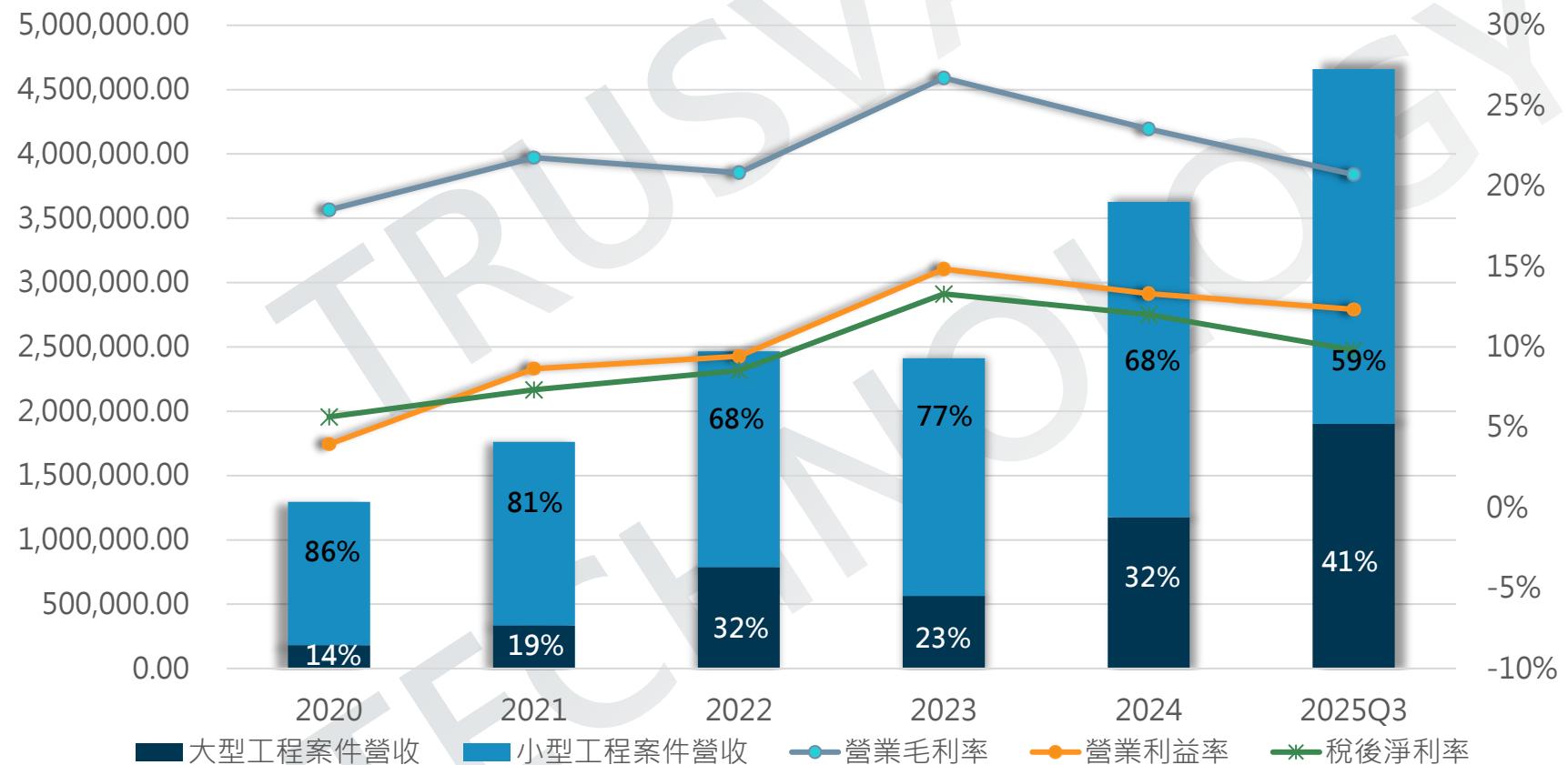
公司簡介 營運概況 競爭優勢 市場分析 未來發展 企業社會責任

單位：仟元/新台幣

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年Q3
營業收入	1,295,835	1,761,103	2,467,205	2,412,630	3,627,781	4,660,309
營業成本	1,055,827	1,377,782	1,953,401	1,767,732	2,773,332	3,694,905
營業毛利	240,008	383,321	513,804	644,898	854,449	965,404
毛利率	18.52%	21.77%	20.83%	26.73%	23.55%	20.72%
營業費用	188,802	230,959	281,432	286,899	371,330	389,329
營業利益	51,206	152,362	232,372	357,999	483,119	576,075
營業利益率	3.95%	8.65%	9.42%	14.84%	13.32%	12.36%
業外收(支)淨額	37,615	18,020	40,252	42,729	71,301	13,726
所得稅(費用)	15,642	41,029	61,844	79,847	118,450	131,769
稅後歸屬於 母公司淨利	73,554	130,103	211,155	321,256	439,623	466,957
EPS(元)	2.04	3.27	5.11	7.17	9.69	9.96

單位：仟元/新台幣；%

近五年獲利能力分析



*註：依接單金額劃分，3,000萬元以上屬大型工程案件，3,000萬元以下屬小型工程案件

公司簡介

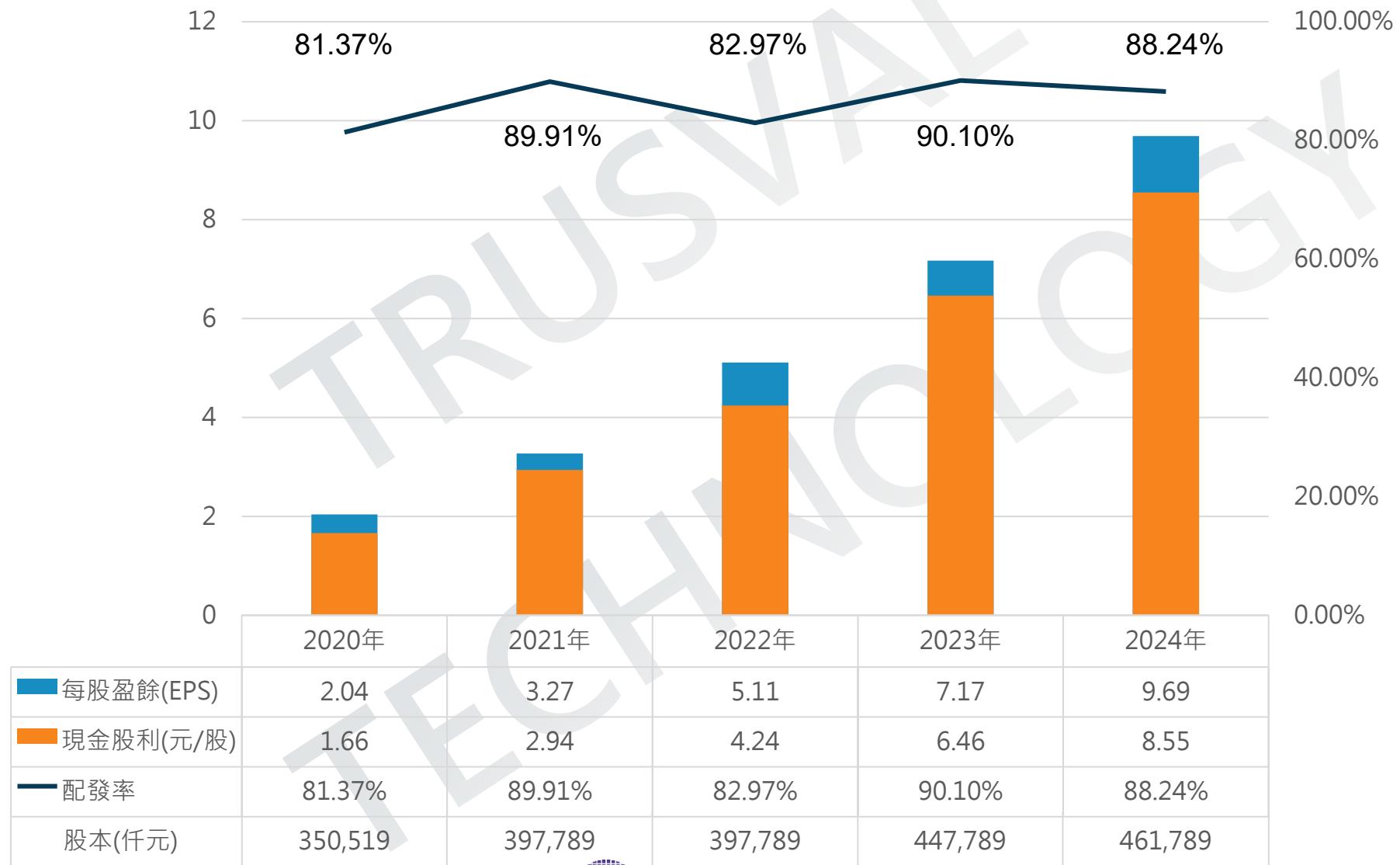
營運概況

競爭優勢

市場分析

未來發展

企業社會責任



半導體製程設備



電子級化學品供應商



半導體製造



電子業 / 資通訊 / 公共機構



光電/面板



晶片封測



太陽能



核心工程能力



製程化學與特氣系統

- 特氣特化供應設備模組
- 系統整合與現場安裝工程



二次配工程

- 設備進機、裝機hook up
- 水氣化設施與專案統包管理



機電統包工程

- 土建、設計、規劃統包工程
- 電力、無塵室、機電、空調系統



綠色建廠與循環經濟解方

- 各式廢液處理系統整合
- 高科技廠循環經濟整廠設計規劃

海外服務據點與在建工程項目



台灣各地特定客戶關鍵案件支援密度

區域	半導體	記憶體	先進封裝	系統工程	二次配
北區	●●●	●	●	●●	●●●
中區	●●	●●●	●	●	●●
南區	●●●	●●	●●●●	●●●	●●●

特氣特化廠務系統、二次配裝機、廢液處理系統

US 美國 JP 日本 DE 德國 (準備中)

特氣特化廠務系統、機電統包工程

TH 泰國

二次配裝機工程

SG 新加坡

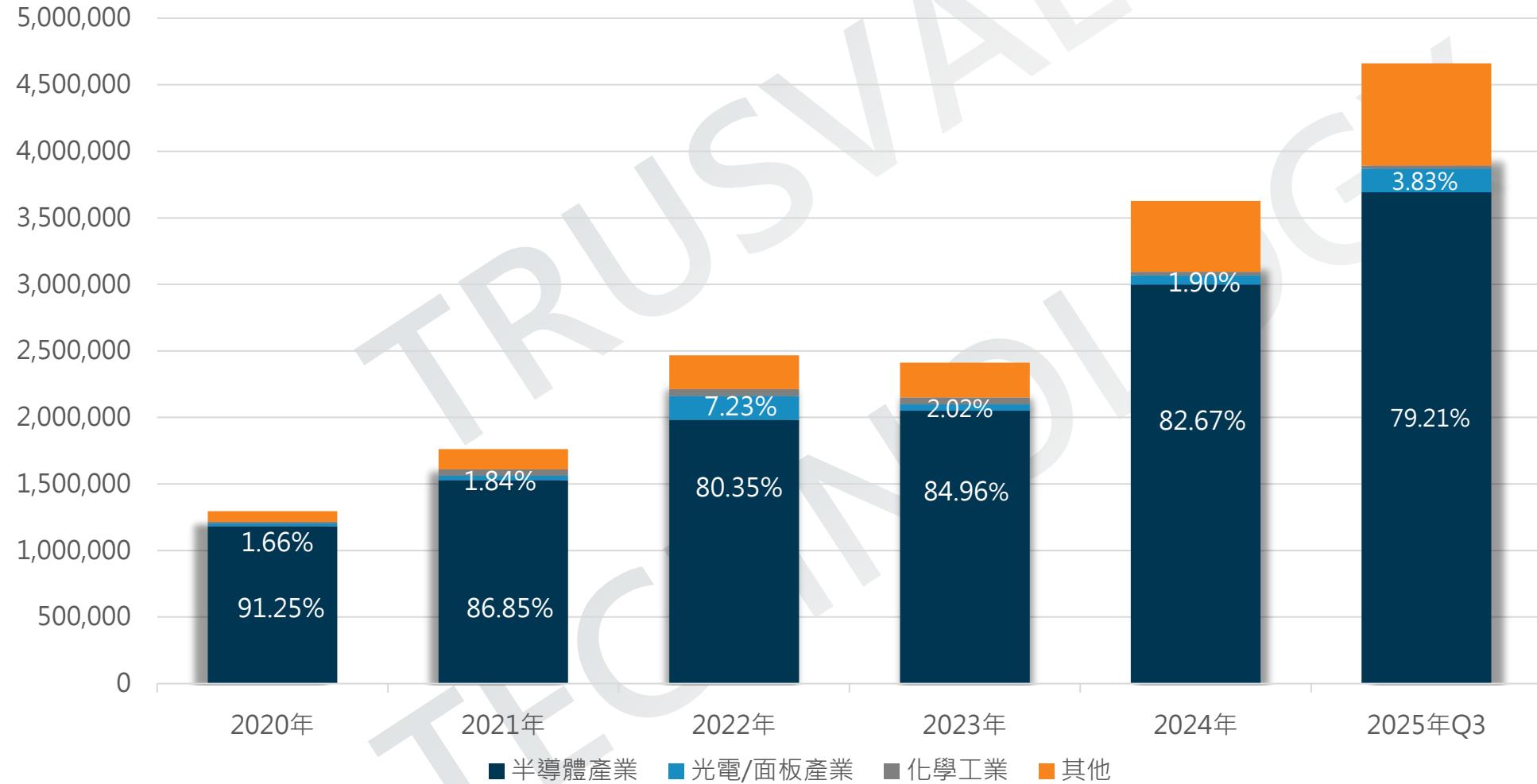
營運概況-按客戶產業別年度營收分析

股票代碼：
6667

單位：仟元/新台幣

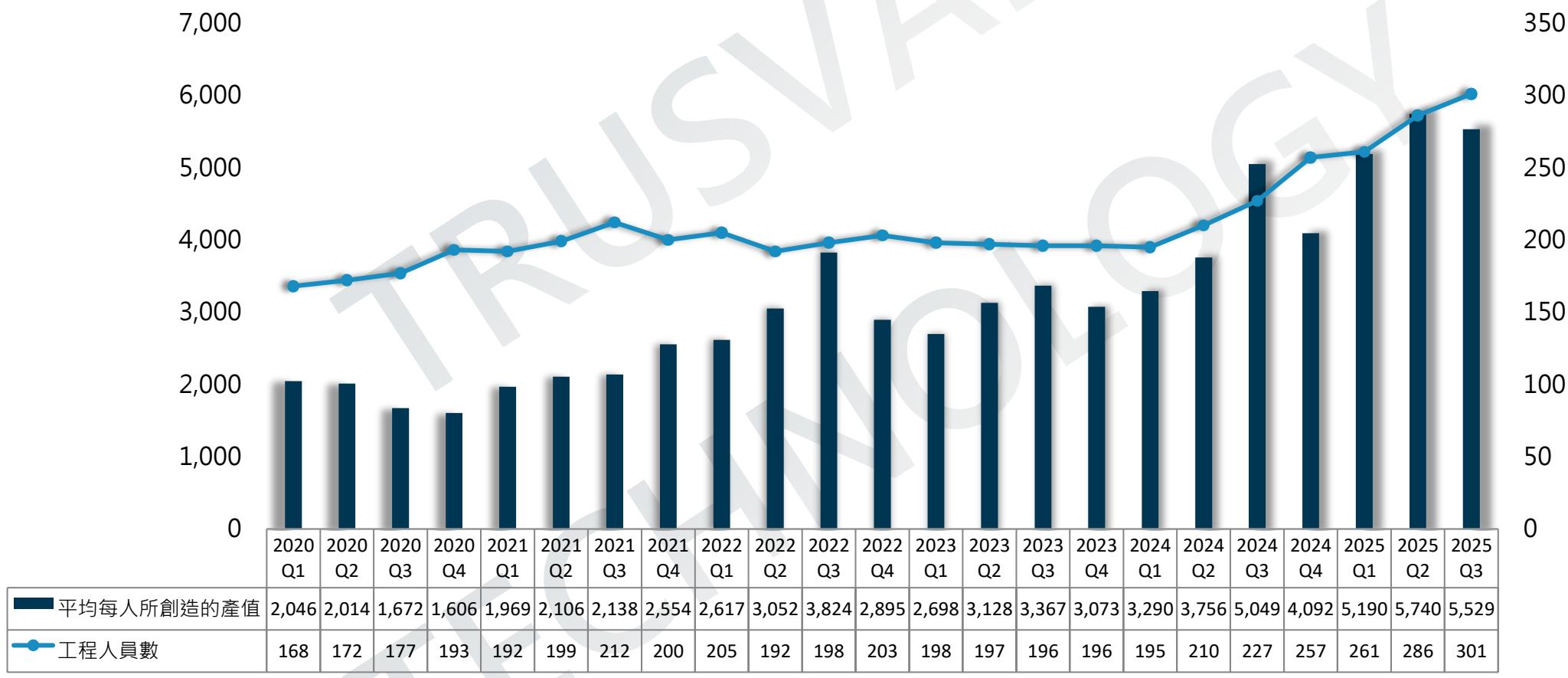
公司簡介 營運概況 競爭優勢 市場分析 未來發展 企業社會責任

單位：%



信穎科技股份有限公司
TRUSVAL TECHNOLOGY CO., LTD.

平均每位工程人員所創造的產值



單位：仟元/新台幣; 人數

深度信任夥伴 Trusted Partnership

- **關鍵客戶長期綁定**：作為晶圓、封測、面板及化工產業之首選工程夥伴，建立高黏著度合作。
- **跨廠區協作模式**：隨客戶擴廠腳步，複製成功經驗，形成高度信任的伴隨式成長

系統整合交付 Turnkey Delivery

- **模組化複製**：將台灣工班隱性技術轉化為標準作業程序 (SOP) 落地到海外符合當地法規安規，實現跨國/跨廠區品質一致性
- **一站式服務**：整合大型案件管理設計、機電、廠務、工安與品保，從規劃到移交完整負責。



現場核心專業 Field Expertise

- **30 年半導體建廠底蘊**：深耕高科技廠務現場專精供應系統整合、二次配工程與廢液處理製程等建廠全方位生命週期參與。
- **精準掌握工程節奏**：具備跨場域施工管理能力，精確控制施工節奏與關鍵風險節點

全球戰略資源 Global Resources

- **戰略性融合工程實力**：結合台灣核心技術團隊與海外在地工班，深度整合挑選能互補且共創價值的夥伴，建立專屬合作接案陣容
- **多國同步展開能力**：具備跨國建廠調度韌性，支援大型專案在台灣、美國、日本、東南亞同步推進

以「系統整合交付、深耕廠務核心底蘊與可規模化戰略工班資源」打造出可被複製的半導體建廠模式，與客戶長期深度合作，成為具備國際競爭力工程整合服務商。

台積電全球先進製程與先進封裝產能布局深化



Fab21		製程	狀況	德國		特殊製程	狀況
P1	4奈米	2024年底投產		ESMC	12/16/22/28奈米	2024年8月興建中	
P2	3奈米	2025年興建/2028年量產		JASM	特殊製程	狀況	
P3	2奈米以下	2025年興建/2030年前量產		P1	12/16/22/28/40奈米	2024年量產/產能80K	
P4~P6	A16	2025年興建P4/2030年後量產		P2	6/7奈米	2025年興建/2027年量產	
2座AP廠、研發中心		規劃中					

台灣		廠區	製程	狀況
南科	Fab18 P9	3奈米	預計2025興建/2027年前量產	
新竹	Fab20 P1	2奈米	2H25年量產	
高雄	P2~P4	2奈米或以下	2025年興建P2~P3/2026-2028年量產	
中科	Fab22 P1	2奈米	2025年底量產	
南科	P2~P5	2奈米或以下	2025年興建P2~P3/2026-2028年量產	
中科	Fab25	2奈米或以下	規劃中	
嘉義	AP7		2025年量產	
南科	AP8		2025年生產/群創廠改建	
未定	AP9		規劃中	

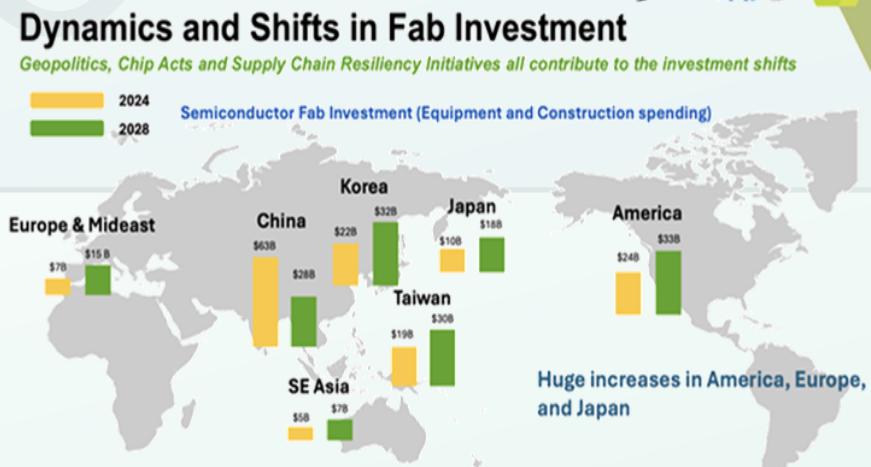
資料來源：SEMI WFF 2025Q2 ; TrendForce Global Fab Outlook, Oct 2025 ; 中信投顧廠務工程簡報

全球先進製程與封裝布局加速：一核心三支點成形

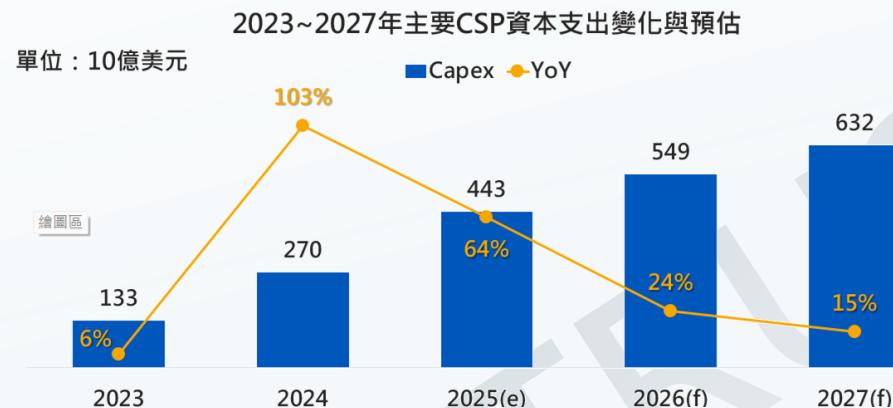
台積電以台灣南科、中科與嘉義作為 2–3nm 的主要量產與研發核心，同時在美國亞利桑那、日本熊本與德國分別布局 3–4nm、車用/先進邏輯與成熟製程，形成「台灣為核心、美日德為戰略支點」的全球架構。此布局展現三大趨勢：先進製程高度集中台灣、海外據點強化供應鏈多極化，以及 CoWoS、SoIC 等先進封裝需求推動產能同步外移，帶動全球建廠節奏持續升溫。

全球建廠版圖轉向美歐日：多極化供應鏈加速成形

2024–2028 年全球晶圓廠投資快速移往美國、歐洲與日本，建廠支出皆成長逾 40%，受晶片法案、地緣政治與在地化需求推動。美國投資由 2,480 億美元升至 3,180 億美元、歐洲倍增至 1,580 億美元、日本提升至 1,880 億美元，成為增速最快的三大市場；整體顯示全球半導體製造正走向多極化，未來 3–5 年美歐日建廠需求將持續攀升，並帶動跨區域工程、機電統包與先進製程配套需求全面擴張。



2027年CSP將持續投資AI基礎建設

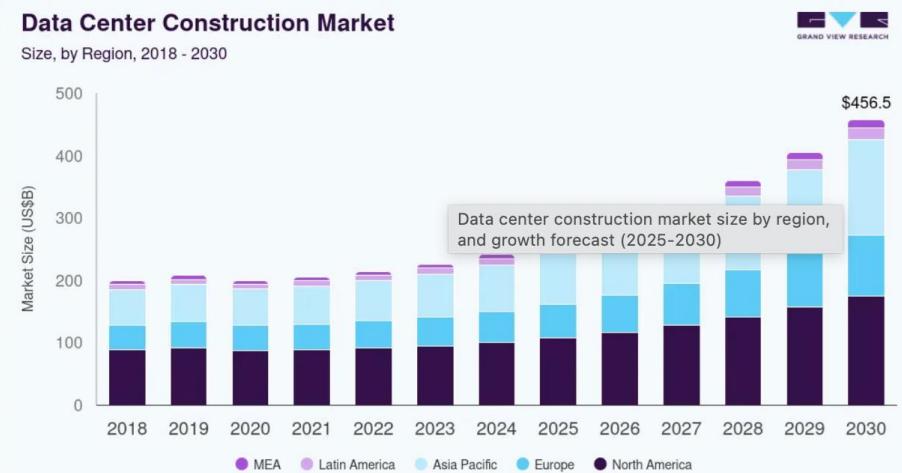


CSP 資本支出強勁成長：AI 基礎建設推升高密度廠 務需求

- 2023–2027 年主要 CSP Capex 從 133 億美元大幅提升至 632 億美元，反映 AI 資料中心快速擴張。對信紜科而言，高功率、高密度機房帶動特氣、化學、排水、配電與冷卻等系統需求成長，正切入公司機電統包與系統整合市場。

全球資料中心建設市場擴張：2025–2030 新建案倍增

- 全球資料中心建設市場預計在 2030 年達 4565 億美元，北美、亞太與歐洲成主要成長引擎。此趨勢與信紜海外布局高度契合，將推升低碳建廠、能源優化、管線與機電廠務工程等核心服務的跨國需求，加速公司切入 AI DC 基礎建設市場。



未來發展-全球高科技產業建廠浪潮推動建廠需求倍增

2025-2030建廠高峰期：雙軌策略鎖定建廠需求倍增目標



1. AI晶片、數據中心等基礎設施推升建廠需求

- 客戶需要在多國同步開展大型專案，尋求具備跨國經驗且可信任的工程夥伴
- 半導體、AI基礎建設、潔淨能源等產業的投資週期長達 3-5 年，帶來穩定的長期訂單能見度。對於廠務系統、機電、廢棄物處理等專業系統整合需求量大且集中



熱點：台灣、美國、日本、東南亞



2. 雙軌接單策略佈局



高能見度關鍵客戶案：

- 隨客戶海外擴產
- 工程統包整合解決方案
- 成廠後維運與廢液循環處理製程



策略性新區域案：

- 在地化營運中心就近服務客戶
- 擴張至當地基礎建設接單
- 當地生態鏈延伸新商機



3. 營運結構性跳升 量體快速放大



2026

建廠規模倍增
(Doubling Factory Scale)



現有專案池足以支撐未來增長
基於產業脈絡趨勢與營運結構調整推算



信穎科技股份有限公司
TRUSVAL TECHNOLOGY CO., LTD.

未來 5–7 年，信紘科將由單一工序承攬商，升級為涵蓋全建廠週期的整廠總承攬商(General Contractor)

此定位變革將使信紘科由「承攬工項」轉為「整廠責任窗口」，掌握專案主導權，提升跨工序協調效率
也能在大型與複雜專案中具備更高的一致性與可靠度
使信紘科在高科技建廠生態系中扮演不可替代的核心角色

信紘科目標



GC

案件總承攬商

EPC

設計採購施工

Trade

系統分包商



信紘科技股份有限公司
TRUSVAL TECHNOLOGY CO., LTD.

未來發展-從系統專業工程商轉型為GC總承攬管理

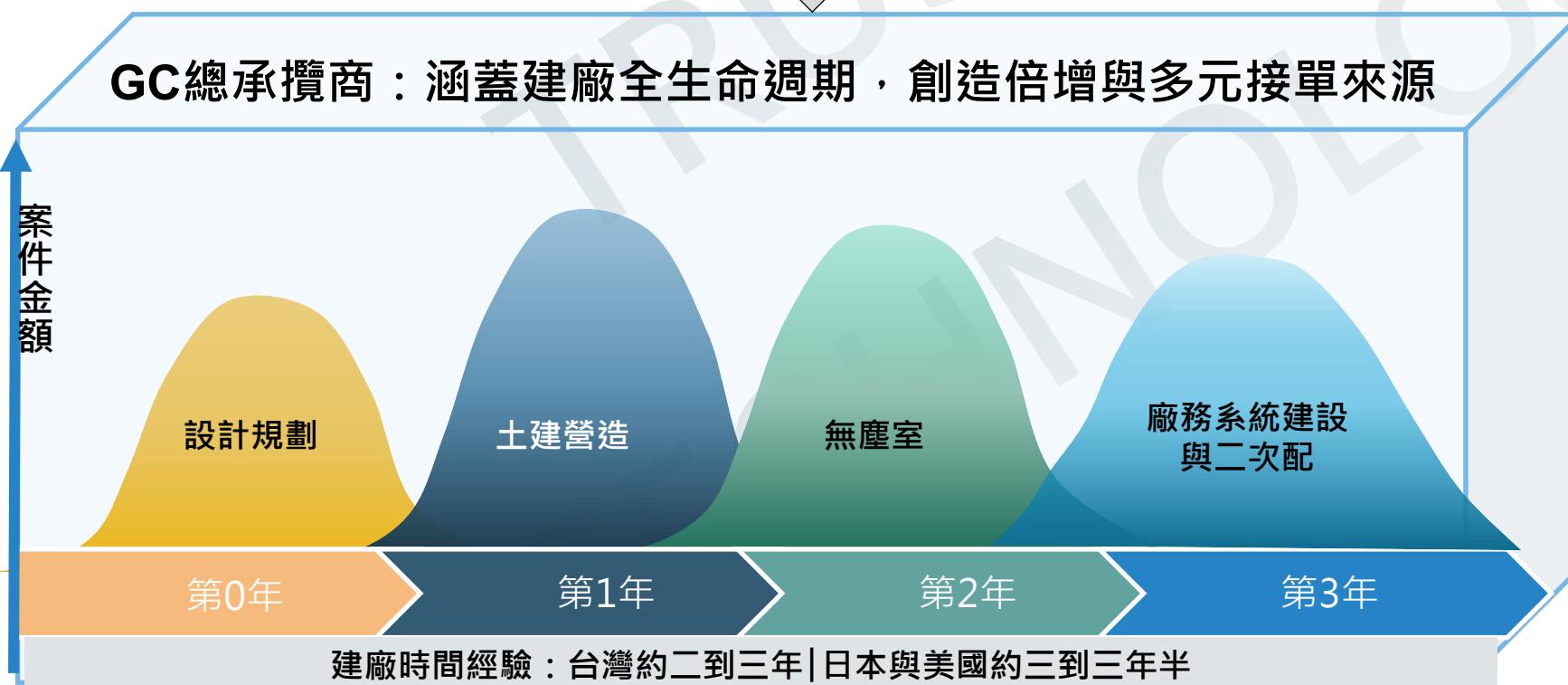
傳統專業分包商接單模式



GC總承攬工程特性

- **高金額貢獻**：涵蓋建廠工程總承攬，從設計規劃一直到基礎建設至完工
- **高主導權**：決定設計方向與發包模式，控管成本與品質
- **高管理利潤**：下游分包採cost plus模式兼顧彈性收益

GC總承攬商：涵蓋建廠全生命週期，創造倍增與多元接單來源



未來發展-從系統專業工程商轉型為GC總承攬管理

公司簡介

營運概況

競爭優勢

市場分析

未來發展

企業社會責任

總承攬商 (GC) 模式升級：地位提升與不可複製的競爭優勢

憑藉精準切入策略與深度夥伴結盟，從專業分包商躍升為系統整合領導者

GC角色地位提升

爭取建廠總承攬管理角色

參與前期設計、規劃，發包與工程管理

掌握大型專案整合利潤

多系統整合管理包，提升技術服務含金量

成為客戶首選介面

統籌一站式窗口，強化長期黏著度

特定系統分包商→掌握全局、管理供應鏈的平台
型總承攬商

三大關鍵策略行動

策略性選擇於關鍵客戶第二、第三座廠房階段切入，避開初期建廠的不確定性與同業競爭

結合在地供應鏈與策略夥伴能力，確保當地執行品質、時效與合規穩定度，解決客戶痛點

戰略性挑選適切夥伴結盟，建立從經營高層到現場執行團隊的高度互信協作模式，部分區域可能採取策略聯盟、商業協作或 JV 等資本合作方式，共建團隊、共享成果與風險

切入時機 + 技術轉化 + 策略聯盟=競爭優勢



信穎科技股份有限公司
TRUSVAL TECHNOLOGY CO., LTD.

日本、美國、東南亞既有基礎將進一步深化，以全球技術、在地交付模式實現永續增長



具體行動

擴大基礎建設承攬範圍

- 鎖定泛高科技產業園區、供應鏈周邊的基礎設施、項目，發揮建廠工程的專業外溢優勢

建立區域型運營中心

- 在關鍵市場（如日本、美國、東南亞）設立在地經營團隊與專案工程團隊，確保接單資質具備在地身份

人才培訓複製機制

- 系統化地將台灣核心技術工班經驗、管理程序、品質控管，透過培訓，融合當地法規安規，成為能海外移動且落地執行工程團隊領導者



全球高科技產業建廠浪潮推動需求基本盤

- 策略: 支援關鍵客戶海內外擴張，以廠務系統、二次配拆裝機turnkey + ESG循環經濟-綠色製程解決方案服務關鍵客戶作為未來三到五年發展事業基本盤

總承攬商GC模式為營收質變關鍵推力

- 策略：從特定系統工程商轉型為大型建廠案件總承攬商，憑藉多年建廠經驗底蘊與深度整合關鍵國際合作夥伴，推動特定區域總承攬管理服務，提升接單專案價值

深化地區型新興市場、掌握基礎建設紅利

- 策略: 地區型新興市場動能將成為建廠景氣週期之間的穩定支撐，強化信穎科的市場能見度與海外在地經營深度，並逐步推進整廠總承攬模式的區域化擴張



落實公司治理

企業經營理念
及社會責任義務宣導



加強投資人關係

增進資訊透明化
重視股東權益



發展永續環境

從公司經營至產品服務的提供
均致力於維護環境的永續性



維護社會公益

符合國際公認基本勞動
人權原則及法規



Your Trustworthy Partner for Advanced Supply System Integration & Green Manufacturing Solution

Unity together COMMUNICATION
COOPERATION CONNECTION NETWORK
Joint Effort Collaboration
Achieve more Interaction
Synergy WHOLE
Working together AGENTS
UNIT CO ACTION Combination
Partnership Teamwork